

## 硅片抛光/减薄/划片加工

产品名称	硅片抛光/减薄/划片加工
公司名称	上海箐岚科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区同普路1175弄3号1楼（注册地址）
联系电话	13816054503

## 产品详情

我们提供硅片加工服务，包括表面研磨抛光，晶圆的背磨减薄，划片加工等

满足科研项目或产品前期研发阶段的特定需求！

所有加工尺寸可对应2英寸（50mm）到12英寸（300mm）。

表面研磨抛光 Polishing

可以指定TTV和Bow，同时也可以要求膜的剥离加工

可选择单面镜面或双面镜面，表面粗超度为Ra1 ~ 10以下

Particle Level N/A, 0.3 μm 10ea, 0.3 μm 30ea

背磨减薄 Back Grinding

研削硅片使得总厚度变薄，最薄可加工到30 μm厚。加工后可对应研磨和清洗

2到5英寸 极限厚度30 μm

6到12英寸 极限厚度 50  $\mu$  m

划片加工Dicing

把硅片切成指定的方形（0.3mm以上）。除了硅片外，也可对应玻璃基盘，石英基盘，陶瓷基盘进行划片加工